

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Беспалов Владимир Александрович
Институт ИНЭЛ НИУ МИЭТ

Должность: Ректор МИЭТ

Дата подписания: 16.07.2024 12:38:42

Уникальный программный ключ:

ef5a4fe6ed0ffdf3f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736d76c8f8bca882b8d602

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Основы технологий электронной компонентной базы»

Направление подготовки - 27.03.05 «Инноватика»

Направленность (профиль) - «Управление наукоемким производством»

Уровень образования - «бакалавриат»

Форма обучения - «очная»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование компетенций в области экспериментального исследования параметров и характеристик технологических процессов создания элементов электроники и наноэлектроники.

Задачи:

- ознакомление с организационно-технологическими основами производства электронной компонентной базы;
- изучение основных технологических процессов микро- и нанотехнологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. Входные требования к дисциплине: знание основ математики, физики и химии, знание материалов электронной техники, знание основных технологических процессов изготовления ИС.

В результате изучения модуля студент должен:

Знать: организационно- технологические основы производства изделий микроэлектроники; основные технологические процессы производства электронной компонентной базы (ЭКБ); конструкции технологического оборудования и методы формирования функциональных слоев и конструктивных элементов полупроводниковых приборов; основные структуры активных элементов ИМС - биполярных и МДП транзисторов; маршруты изготовления ЭКБ.

Уметь: составлять краткие технологические маршруты изготовления различных элементов ИС; проводить исследования влияния операционных параметров на технологические характеристики процессов изготовления ИС; сравнивать различные методы формирования функциональных слоев ИС.

Опыт деятельности: по экспериментальному исследованию функциональных элементов активных структур.

3. Краткое содержание дисциплины

Организационно-технологические основы производства изделий микро- и наноэлектроники. Физико-химические методы обработки поверхности. Термическое окисление. Термическая диффузия. Ионное легирование. Литография. Эпитаксия. Металлизация. Интегрированные кластерные технологические комплексы. Нанотехнологии в электронике.

Разработчик:

проф., д.т.н. Шевяков В.И.